

tesa HAF® 8440 HS



Informacja O Produkcie

40 µm przezroczysta taśma montażowa HAF

Opis produktu

Cechy

- Niezawodne łączenie modułu chipowego
- Odpowiednia do kart PVC, ABS i PC
- Dobra obróbka na wszystkich popularnych liniach implantacyjnych
- Dobra odporność na starzenie
- Niewidoczna po zamontowaniu w karcie

Zastosowania

tesa HAF® 8440 jest specjalnie zaprojektowana do osadzania modułów chipowych w kartach inteligentnych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| • Materiał nośnika | brak | • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany |
| • typ substancji klejącej | kopoliamid | • grubość całkowita | 40 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | |
|-----------------|----------------------|
| • siła łączenia | 12 N/mm ² |
|-----------------|----------------------|

Dodatkowe informacje

Zalecenia techniczne:

Poniższe wartości są rekomendowanymi parametrami maszynowymi na początek. Proszę pamiętać, że optymalne parametry silnie zależą od typu maszyny, konkretnych materiałów korpusu kart i modułów chipowych, jak również wymagań klienta.

1. Przed-laminacja:

Podczas przed-laminacji taśma klejąca jest naklejana na taśmę modułową. Ten etap może być wykonywany inline lub offline. Przed-laminacja nie wpływa na okres przydatności taśmy klejącej do użycia.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=8440>

tesa HAF® 8440 HS

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

Ustawienia maszyny:

- Temperatura: 130-140 °C
- Ciśnienie: 2-3 bar
- Czas: 2,5 m/min

2. Osadzanie modułu:

Podczas osadzania modułu, przed-laminowane moduły są wycinane z taśmy modułowej, pozycjonowane w otworze karty oraz trwale łączone z obudową karty za pomocą ciepła i nacisku. W tym etapie dokładny sposób obsługi zależy od rodzaju używanej linii implantacyjnej. Używać można trybu jednoetapowego lub wieloetapowego. Obecnie powszechnie stosuje się tryb wieloetapowy:

Proces jednoetapowy – ustawienia maszyny:

- Temperatura¹: 180–220 °C
- Ciśnienie: 65-75 N/moduł
- Czas: 1,5 s

Proces wieloetapowy (2 lub więcej stempli grzewczych) – ustawienia maszyny:

- Temperatura¹: 180–220 °C
- Ciśnienie: 65-75 N/moduł
- Czas: 2 x 0,7 s / 3 x 0,5 s

¹ Temperatura mierzona wewnątrz stempla grzewczego. Inne ustawienia temperatury są zalecane dla różnych materiałów kart:

*PVC: 180-190 °C

*ABS: 180-190 °C

*PC: 200-220 °C

Dla aplikacji innych niż implantacja modułów chipowych należy stosować inne parametry maszynowe.

tesa HAF® 8440 HS

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

Wartości wytrzymałości połączenia uzyskano w standardowych warunkach laboratoryjnych. Wartość ta jest gwarantowaną granicą kontrolowaną przy każdej partii produkcyjnej (Materiał: próbka testowa z trawionego aluminium / Warunki klejenia: temperatura = 120 °C; ciśnienie = 10 bar; czas = 8 min)

Warunki przechowywania zgodnie z koncepcją okresu trwałości tesa HAF®.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=8440>